

低誘電カバーレイ 『C23タイプ』

使用例

- ・5Gスマートフォン
- ・アンテナ基地局
- ・ADAS（先進運転支援システム）

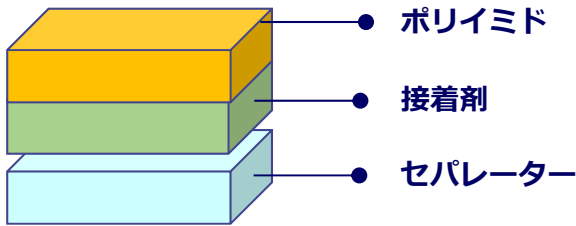


特徴

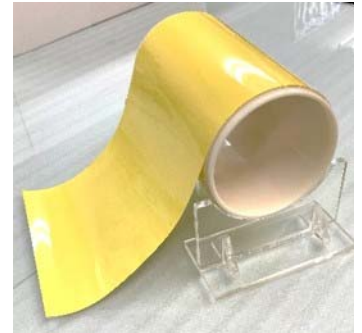
- ・低誘電率、低誘電正接を有するカバーレイです。

誘電率(Dk) : 2.4、誘電正接 (Df) : 0.003 @10GHz

構成



製品外観

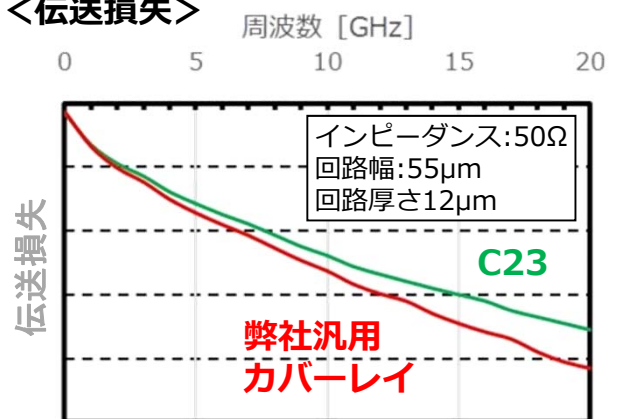


特性

項目	単位	C23	
ポリイミド厚さ	μm	12.5	
接着剤厚さ	μm	25	
誘電率 (10GHz)	カバーレイ	-	2.75
	接着層	-	2.43
誘電正接 (10GHz)	カバーレイ	-	0.005
	接着層	-	0.003
引き剥がし強さ(90°PI引き)	N/cm	5.5	
はんだ耐熱性 (30秒フロート)	-	Pass	

プレス条件 : 160°C×3MPa×60min

＜伝送損失＞



サンプル構成

銅箔 12μm
ポリイミド 25μm
接着剤 25μm
銅箔 12μm
ポリイミド 25μm
銅箔 12μm (GND)